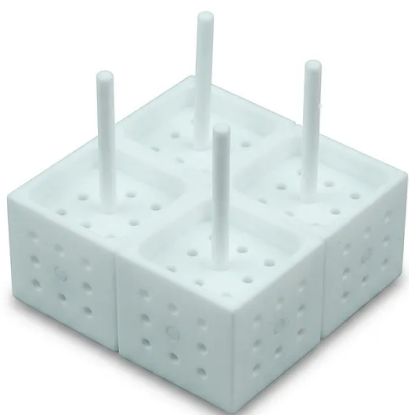


Cestello Portawafers In Ptfе Personalizzato Per La Pulizia Chimica, Resistente Ai Prodotti Chimici, In Fluoropolimero Per L'incisione Dei Semiconduttori E La Lavorazione Delle Nuove Energie

Numero articolo: PL-CP149



introduzione

Ottimizza la tua produzione di semiconduttori e nuove energie con cestelli portawafers personalizzati in PTFE. Progettati per una resistenza chimica estrema durante l'incisione e la pulizia RCA, questi portatori in fluoropolimero ad alta purezza garantiscono l'integrità del processo e una durata a lungo termine in ambienti industriali impegnativi.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Pulizia RCA dei Semiconduttori	Pulizia sequenziale dei wafer di silicio utilizzando soluzioni SC-1 e SC-2 per rimuovere contaminanti organici e metallici.	Zero contaminazione e resistenza alle miscele ammoniaca/perossido.
Incisione con Acido Fluoridrico (HF)	Rimozione degli ossidi nativi o incisione controllata degli strati di biossido di silicio sulle superfici dei wafer.	Resistenza assoluta all'HF, che dissolverebbe alternative in vetro o quarzo.
Strutturizzazione Fotovoltaica	Incisione chimica a umido di wafer di silicio monocristallino o policristallino per creare superfici che intrappolano la luce.	L'allineamento uniforme delle fessure garantisce una strutturizzazione uniforme su grandi lotti.
Lavorazione con Soluzione Piranha	Rimozione aggressiva di residui organici e fotosist utilizzando acido solforico e perossido di idrogeno.	Resiste a reazioni esotermiche estreme e acidità ad alta temperatura.
Risciacquo Post-CMP	Pulizia critica dei wafer dopo la levigatura chimico-meccanica per rimuovere le sospensioni abrasive.	Superfici lisce e alto drenaggio prevengono la rideposizione di particelle.
Preparazione Semiconduttori Composti	Pulizia specializzata di wafer GaAs o InP per la fabbricazione avanzata di dispositivi elettronici e optoelettronici.	Geometria delle fessure personalizzabile per spessori e dimensioni dei wafer non standard.
Caricamento Reattori a Microcanali	Posizionamento di substrati all'interno di camere di reazione personalizzate per la deposizione controllata di vapore chimico o in fase liquida.	Dimensioni su misura consentono un perfetto adattamento in configurazioni di laboratorio personalizzate.
Sviluppo Litografico	Tenuta dei substrati durante lo sviluppo e la rimozione degli strati di fotosist nei flussi di lavoro di microfabbricazione.	La resistenza ai solventi garantisce che il portatore non si degradi o rilasci gas durante il processo.

Parametro	Dettaglio Specifica per PL-CP149	
Identificativo Modello	Serie PL-CP149	
Costruzione Materiale	PTFE (Polietilene a bassa densità) Vergine ad Alta Purezza al 100%	
Metodo di Produzione	Compatibilità Chimica	Universale (Acidi, Basi, Solventi, Ossidanti, HF)
Intervallo di Temperatura Operativa	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)	
Compatibilità Wafer	Personalizzabile per dimensioni 2", 3", 4", 6", 8", 12" o non standard	
Configurazione Fessure	Completamente Personalizzabile (Passo, larghezza e profondità variabili)	

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Parametro	Dettaglio Specifica per PL-CP149	
Numero Fessure	Definito per requisito cliente (es. capacità 10, 25, 50)	
Design Maniglia	Integrata, Staccabile o Estesa (Lunghezza personalizzabile)	
Finitura Superficiale	Finitura lavorata liscia, a bassa porosità	
Standard di Purezza	Adatto per Analisi di Tracce e uso in Cleanroom Classe 10/100	
Caratteristiche di Drenaggio	Porti di drenaggio inferiore/laterali personalizzabili	